無電解銅めっき触媒用銅ペースト

Copper paste for electroless copper plating catalyst

OPCコパシードSCP

OPC COPASEED SCF

- 無電解銅めっきを併用して高い導電性
 High conductivity by combination with electroless copper plating
- 低温での硬化が可能でフィルムに対応 Low temperature curing is possible and good compatibility with films
- 無電解銅めつきの優れた析出性
 Excellent depositability of electroless copper plating
- ・良好な密着性 Excellent adhesion

OPCコパシードSCP + 無電解銅めっき

OPC COPASEED SCP + Electroless copper plating

OPCコパシードSCPを用いた配線形成方法

Pattern formation method using OPC COPASEED SCP

1 スクリーン印刷 Screen printing

スクリーン印刷で配線形成 (導電性なし)

Pattern formation by screen printing
(No conductivity)

2

無電解銅めっき Electroless copper plating

無電解銅めっきにて

配線を導体化 Electroless copper plating to make patterns conductive ① 高い導電性

High conductivity

③ 環境対応 Eco-friendly

Process reduction

④ 低コスト化

Cost reduction

導電性ペーストのみの配線形成時の課題

Issues when pattern is formed using only conductive paste

- 酸化による導電性の低下
 Decrease in conductivity by oxidation
- マイグレーションの発生 Migration occurrence
- 抵抗値の確保で厚膜化
 Thick film by securing resistance value
- 価格の変動・高騰 Price fluctuations and price hikes

一般的なプリント基板の配線形成方法

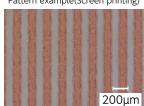
General PCB wiring formation method

廃液発生 Generation of liquid waste 2 3 4 5 6 レジスト塗布 現像 エッチング レジスト除去 銅箔形成 露光 developing Copper foil **Resist Coating** (photographic) Etching Removal exposure formation (film) of resist _ _ _

低温で硬化が可能な銅ペースト

Copper paste curable at low temperatures

配線形成例(スクリーン印刷) Pattern example(Screen printing)

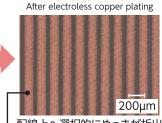


120℃1時間で硬化 Curing at 120℃ for 1 h

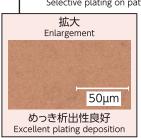
低温硬化のため フィルムに対応可能

Compatible with films due to low temperature curing

無電解銅めっき後



配線上へ選択的にめっきが析出 Selective plating on pattern



良好な密着性

Excellent adhesion

Peel strength 4 N/cm 3.5 N/cm 2 1 -

基材

Substrates

PΙ

PET

ピール強度